

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum

26. September 2013 (26.09.2013)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

WO 2013/139366 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

H01L 21/67 (2006.01) B23K 20/02 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2012/054808

(22) Internationales Anmeldedatum:
19. März 2012 (19.03.2012)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): EV GROUP E. THALLNER GMBH [AT/AT];
1, DI Erich Thallner Straße, A-4782 St. Florian am Inn
(AT).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BURGGRAF, Jürgen
[AT/AT]; 34, Wernsteinerstraße, A-4780 Schärding (AT).
HANGWEIER, Peter-Oliver [AT/AT]; 25, Hofmark, A-
4742 Pram (AT). PERAU, Christian [AT/AT]; 1,
Neupirath, A-4950 Altheim (AT).

(74) Anwälte: SCHWEIGER, Johannes et al.; 22, Turmstraße,
40878 Ratingen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY,
BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,
ZW.

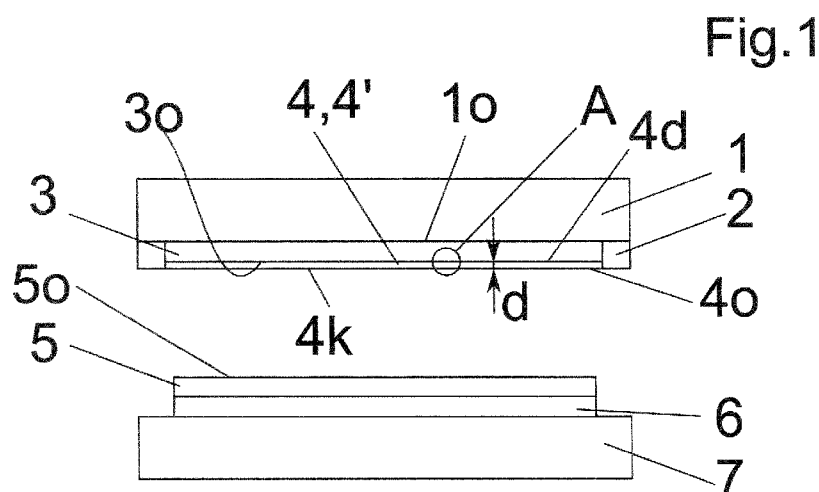
(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ,
TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,
MD, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE,
IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

(54) Title: PRESSURE TRANSFER PLATE FOR PRESSURE TRANSFER OF A BONDING PRESSURE

(54) Bezeichnung : DRUCKÜBERTRAGUNGSPLATTE ZUR DRUCKÜBERTRAGUNG EINES BONDINGDRUCKS



(57) Abstract: The invention relates to a pressure transfer plate for pressure transfer of a bonding pressure, particularly in thermo-compression bonding, from a pressure application device to a wafer comprising: - a first pressure face for making contact with the pressure application device, - a second pressure face, facing away from the first pressure face, having an effective contact area for making contact with and applying pressure to said wafer, wherein at least the effective contact area has a low adhesion capability in relation to the wafer. The invention further relates to an application of the pressure transfer plate in bonding.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Druckübertragungsplatte zur Druckübertragung eines Bondingdrucks, insbesondere beim Thermokompressionsbonds, von

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



WO 2013/139366 A1



einer Druckbeaufschlagungseinrichtung auf einen Wafer mit: - einer ersten Druckseite zur Kontaktierung der Druckbeaufschlagungseinrichtung, - einer zweiten, der von der ersten Druckseite abgewandten Druckseite mit einer wirksamen Kontaktfläche zur Kontaktierung und Druckbeaufschlagung des Wafers, wobei zumindest die wirksame Kontaktfläche eine geringe Adhäsionsfähigkeit gegenüber dem Wafer aufweist. Weiterhin betrifft die Erfindung eine Verwendung der Druckübertragungsplatte beim Bonden.